

2024-2030年中国芯片市场 深度评估与未来前景预测报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2024-2030年中国芯片市场深度评估与未来前景预测报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202310/412346.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

芯片（chip）就是半导体元件产品的统称，是集成电路的载体，由晶圆分割而成。芯片制作完整过程包括芯片设计、晶片制作、封装制作、成本测试等环节，其中晶片制作过程尤为的复杂。

受益于政策的大力扶持，近年来中国芯片产业销售额增长迅速，市场空间广阔。2020年，中国集成电路产业销售额为8848亿元，同比增长17%。其中，设计业销售额为3778.4亿元，同比增长23.3%；制造业销售额为2560.1亿元，同比增长19.1%；封装测试业销售额2509.5亿元，同比增长6.8%。2021年1-9月，中国集成电路产业销售额为6858.6亿元，同比增长16.1%。其中，设计业同比增长18.1%，销售额3111亿元；制造业同比增长21.5%，销售额为1898.1亿元；封装测试业同比增长8.1%，销售额1849.5亿元。

从企业数量上看，2011年以来的十年之间，芯片企业注册量呈逐年增长趋势，2011年共注册芯片企业1180家，到了2020年，芯片企业注册量呈井喷式增长，共2.17万家，同比增长216%。2021年上半年芯片相关企业新增1.88万家，同比增长171.8%；2020年同期的注册量仅为0.69万家。目前我国现存芯片相关企业7.2万家，其中深圳1.3万家、广州0.6万家、上海0.4万家是拥有芯片企业最多的城市。值得注意的是，广东省以2.3万家企业位列第一，占比总量的31.9%。

2020年8月，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》（简称《若干政策》）。《若干政策》强调集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。国务院印发《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》以来，我国集成电路产业和软件产业快速发展，有力支撑了国家信息化建设，促进了国民经济和社会持续健康发展。2021年7月2日，工信部、科技部、财政部、商务部、国资委、证监会六大部委联合发布的《加快培育发展制造业优质企业的指导意见》中，专门强调了要加大集成电路等领域核心技术、产品、装备的攻关。这一文件体现了国家对集成电路等关键行业的高度重视和支持，背后也反映了当前我国集成电路产业面临复杂的形势：美国对我国集成电路产业持续打压，国产替代需求迫切。

近十年我国芯片半导体赛道共发生投融资事件3169件，总投融资金额超6025亿元，2020年共发生投融资事件458起，总融资金额高达1097.69亿元，共有16家企业超过10亿元，最高融资金额被中芯国际拿下，合计198.5亿元。

中企顾问网发布的《2024-2030年中国芯片市场深度评估与未来前景预测报告》共十三章。首先介绍了芯片行业的总体概况，接着分析了中国芯片行业发展环境、芯片市场总体发展状况

。然后分别对芯片产业的产业链市场及相关重点企业进行了详尽的透析。最后，报告对芯片行业进行了投资分析并对行业未来发展前景进行了科学的预测。

本研究报告数据主要来自于国家统计局、中国半导体行业协会、工信部、中国海关总署、中企顾问网以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对芯片产业链有个系统深入的了解、或者想投资芯片相关行业，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。

报告目录：

第一章 芯片相关概念介绍

1.1 芯片的概念

1.1.1 芯片的定义

1.1.2 集成电路的内涵

1.1.3 集成电路行业概述

1.1.4 芯片及相关概念辨析

1.1.5 芯片制程工艺的概念

1.2 芯片常见类型

1.2.1 LED芯片

1.2.2 手机芯片

1.2.3 电脑芯片

1.2.4 大脑芯片

1.2.5 生物芯片

1.3 芯片制作过程

1.3.1 晶圆制作

1.3.2 晶圆涂膜

1.3.3 光刻显影

1.3.4 离子注入

1.3.5 晶圆测试

1.3.6 芯片封装

1.3.7 测试包装

第二章 2021-2023年中国芯片行业发展环境分析

2.1 经济环境

- 2.1.1 宏观经济运行
- 2.1.2 对外经济分析
- 2.1.3 工业运行情况
- 2.1.4 宏观经济展望
- 2.2 政策环境
 - 2.2.1 半导体行业政策
 - 2.2.2 集成电路相关政策
 - 2.2.3 各国芯片扶持政策
 - 2.2.4 芯片行业政策汇总
 - 2.2.5 行业政策影响分析
 - 2.2.6 十四五行业政策展望
- 2.3 产业环境
 - 2.3.1 全球半导体市场规模
 - 2.3.2 全球半导体资本开支
 - 2.3.3 全球半导体产品结构
 - 2.3.4 全球半导体竞争格局
 - 2.3.5 中国半导体销售收入
 - 2.3.6 中国半导体驱动因素
 - 2.3.7 国外半导体经验借鉴
 - 2.3.8 半导体产业发展展望
- 2.4 技术环境
 - 2.4.1 芯片技术发展战略意义
 - 2.4.2 芯片科技发展基本特征
 - 2.4.3 芯片关键技术发展进程
 - 2.4.4 芯片企业技术发展态势
 - 2.4.5 芯片科技未来发展趋势
 - 2.4.6 后摩尔时代颠覆性技术
 - 2.4.7 中美科技战对行业的影响

第三章 2021-2023年中国芯片行业及产业链发展分析

- 3.1 芯片及相关产业链分析
 - 3.1.1 半导体产业链结构

- 3.1.2 集成电路产业链分析
- 3.1.3 芯片产业链结构分析
- 3.1.4 芯片产业链发展现状
- 3.1.5 芯片产业链竞争格局
- 3.1.6 芯片产业链重点企业
- 3.1.7 芯片产业链技术发展
- 3.1.8 芯片产业链国产替代
- 3.1.9 芯片产业链发展意义
- 3.2 中国芯片产业发展现状
 - 3.2.1 中国芯片发展历程
 - 3.2.2 芯片行业特点概述
 - 3.2.3 大陆芯片市场规模
 - 3.2.4 芯片企业数量分析
 - 3.2.5 芯片产业结构状况
 - 3.2.6 芯片国产化率分析
 - 3.2.7 芯片短缺原因分析
 - 3.2.8 芯片短缺应对措施
- 3.3 集成电路市场运行状况
 - 3.3.1 全球集成电路市场规模
 - 3.3.2 中国集成电路市场规模
 - 3.3.3 国产集成电路市场规模
 - 3.3.4 中国集成电路产量状况
 - 3.3.5 中国集成电路进出口量
 - 3.3.6 中国集成电路产品结构
 - 3.3.7 集成电路产量区域分布
 - 3.3.8 集成电路产业商业模式
- 3.4 中国芯片行业区域格局分析
 - 3.4.1 芯片产业城市格局
 - 3.4.2 江苏芯片产业发展
 - 3.4.3 广东芯片产业发展
 - 3.4.4 上海芯片产业发展
 - 3.4.5 北京芯片产业发展

- 3.4.6 陕西芯片产业发展
- 3.4.7 浙江芯片产业发展
- 3.4.8 安徽芯片产业发展
- 3.4.9 福建芯片产业发展
- 3.4.10 湖北芯片产业发展
- 3.5 中国芯片产业发展问题
 - 3.5.1 芯片产业总体问题
 - 3.5.2 芯片技术发展问题
 - 3.5.3 芯片人才问题分析
 - 3.5.4 芯片项目问题分析
 - 3.5.5 国内外产业的差距
 - 3.5.6 芯片国产化发展问题
- 3.6 中国芯片产业发展策略
 - 3.6.1 芯片产业政策建议
 - 3.6.2 芯片技术研发建议
 - 3.6.3 芯片人才培养策略
 - 3.6.4 芯片项目监管建议
 - 3.6.5 芯片产业发展路径
 - 3.6.6 芯片国产化发展建议

第四章 2021-2023年中国芯片行业细分产品分析

- 4.1 逻辑芯片
- 4.2 存储芯片
 - 4.2.1 存储芯片行业地位
 - 4.2.2 全球存储芯片规模
 - 4.2.3 中国存储芯片规模
 - 4.2.4 存储芯片市场结构
 - 4.2.5 NAND Flash市场
 - 4.2.6 DRAM市场规模
 - 4.2.7 存储芯片发展前景
- 4.3 微处理器
 - 4.3.1 微处理器产业链

- 4.3.2 全球微处理器规模
- 4.3.3 中国微处理器规模
- 4.3.4 微处理器应用前景
- 4.4 模拟芯片
 - 4.4.1 模拟芯片产品结构
 - 4.4.2 全球模拟芯片规模
 - 4.4.3 全球模拟芯片竞争
 - 4.4.4 中国模拟芯片规模
 - 4.4.5 国产模拟芯片厂商
 - 4.4.6 模拟芯片投资现状
 - 4.4.7 模拟芯片发展机遇
- 4.5 CPU芯片
 - 4.5.1 CPU芯片发展概况
 - 4.5.2 全球CPU需求规模
 - 4.5.3 全球CPU竞争格局
 - 4.5.4 国产CPU需求规模
 - 4.5.5 中国CPU参与主体
 - 4.5.6 CPU生态发展必要性
 - 4.5.7 CPU产业发展策略
 - 4.5.8 中国CPU发展前景
 - 4.5.9 国产CPU发展机遇
 - 4.5.10 国产CPU面临挑战
- 4.6 其他细分产品
 - 4.6.1 GPU芯片
 - 4.6.2 FPGA芯片
 - 4.6.3 指令集架构

第五章 2021-2023年芯片上游——半导体材料市场分析

- 5.1 半导体材料行业发展综述
 - 5.1.1 半导体材料主要类型
 - 5.1.2 全球半导体材料规模
 - 5.1.3 全球半导体材料占比

- 5.1.4 全球半导体材料结构
- 5.1.5 半导体材料区域分布
- 5.1.6 中国半导体材料规模
- 5.1.7 半导体材料竞争格局
- 5.2 半导体硅片行业发展态势
 - 5.2.1 半导体硅片主要类型
 - 5.2.2 半导体硅片产能状况
 - 5.2.3 半导体硅片出货规模
 - 5.2.4 半导体硅片价格走势
 - 5.2.5 半导体硅片市场规模
 - 5.2.6 半导体硅片产品结构
 - 5.2.7 半导体硅片竞争格局
 - 5.2.8 半导体硅片供需状况
- 5.3 光刻胶行业发展现状分析
 - 5.3.1 光刻胶产业链
 - 5.3.2 光刻胶主要类型
 - 5.3.3 光刻胶市场规模
 - 5.3.4 光刻胶细分市场
 - 5.3.5 光刻胶竞争格局
 - 5.3.6 半导体光刻胶厂商
 - 5.3.7 光刻胶技术水平
 - 5.3.8 光刻胶行业壁垒
- 5.4 其他晶圆制造材料发展状况
 - 5.4.1 靶材
 - 5.4.2 抛光材料
 - 5.4.3 电子特气

第六章 2021-2023年芯片上游——半导体设备市场分析

- 6.1 半导体设备行业市场运行分析
 - 6.1.1 半导体设备投资占比
 - 6.1.2 全球半导体设备规模
 - 6.1.3 全球半导体设备竞争

- 6.1.4 中国半导体设备规模
- 6.1.5 国产半导体设备发展
- 6.1.6 硅片制造核心设备分析
- 6.2 集成电路制造设备发展现状
 - 6.2.1 集成电路制造设备分类
 - 6.2.2 集成电路制造设备特点
 - 6.2.3 集成电路制造设备规模
 - 6.2.4 集成电路制造设备厂商
 - 6.2.5 集成电路制造设备国产化
- 6.3 光刻机
 - 6.3.1 光刻机产业链
 - 6.3.2 光刻机市场销量
 - 6.3.3 光刻机产品结构
 - 6.3.4 光刻机竞争格局
 - 6.3.5 国产光刻机技术
 - 6.3.6 光刻机重点企业
- 6.4 芯片刻蚀设备
 - 6.4.1 芯片刻蚀工艺流程
 - 6.4.2 刻蚀设备市场规模
 - 6.4.3 刻蚀设备竞争格局
 - 6.4.4 刻蚀设备企业动态
- 6.5 薄膜沉积设备
 - 6.5.1 薄膜沉积技术基本介绍
 - 6.5.2 薄膜沉积设备主要类型
 - 6.5.3 薄膜沉积设备市场规模
 - 6.5.4 薄膜沉积设备产品结构
 - 6.5.5 薄膜沉积设备竞争格局
 - 6.5.6 薄膜沉积设备发展趋势
- 6.6 其他半导体制造核心设备基本介绍
 - 6.6.1 去胶设备
 - 6.6.2 热处理设备
 - 6.6.3 薄膜生长设备

- 6.6.4 清洗设备
- 6.6.5 离子注入设备
- 6.6.6 涂胶显影设备

第七章 2021-2023年芯片中游——芯片设计发展分析

7.1 2021-2023年中国芯片设计市场运行分析

- 7.1.1 芯片设计工艺流程
- 7.1.2 芯片设计运作模式
- 7.1.3 芯片设计市场规模
- 7.1.4 芯片设计企业数量
- 7.1.5 芯片设计竞争格局
- 7.1.6 芯片设计发展现状
- 7.1.7 芯片设计面临挑战

7.2 半导体IP行业

- 7.2.1 半导体IP行业地位
- 7.2.2 半导体IP商业模式
- 7.2.3 全球半导体IP市场
- 7.2.4 全球半导体IP竞争
- 7.2.5 中国半导体IP规模
- 7.2.6 国内半导体IP厂商
- 7.2.7 中国半导体IP动态
- 7.2.8 半导体IP行业壁垒
- 7.2.9 半导体IP应用前景

7.3 电子设计自动化（EDA）行业

- 7.3.1 EDA产业链分析
- 7.3.2 EDA行业发展历程
- 7.3.3 全球EDA市场规模
- 7.3.4 全球EDA竞争格局
- 7.3.5 中国EDA市场规模
- 7.3.6 国内EDA竞争格局
- 7.3.7 中国本土EDA厂商
- 7.3.8 EDA主要应用场景

- 7.3.9 EDA企业商业模式
- 7.3.10 EDA技术演变路径
- 7.3.11 EDA行业进入壁垒
- 7.3.12 EDA行业发展机遇
- 7.3.13 EDA行业面临挑战
- 7.4 集成电路布图设计行业
 - 7.4.1 布图设计相关概念
 - 7.4.2 布图设计专利数量
 - 7.4.3 布图设计发展现状
 - 7.4.4 布图设计登记策略

第八章 2021-2023年芯片中游——芯片制造解析

8.1 2021-2023年芯片制造产业发展综述

- 8.1.1 芯片制造工艺流程
- 8.1.2 芯片制造市场规模
- 8.1.3 芯片制造企业排名
- 8.1.4 芯片制造产业现状
- 8.1.5 芯片制程技术对比
- 8.1.6 芯片制程产能分布
- 8.1.7 先进制程研发进展

8.2 晶圆制造产业发展现状

- 8.2.1 全球晶圆产能现状
- 8.2.2 全球硅晶圆出货量
- 8.2.3 中国晶圆制造规模
- 8.2.4 中国晶圆产能规划
- 8.2.5 晶圆制造设备及材料
- 8.2.6 中国台湾晶圆制造
- 8.2.7 不同尺寸晶圆产能
- 8.2.8 晶圆短缺影响分析

8.3 8英寸晶圆制造产业分析

- 8.3.1 8英寸晶圆产业链
- 8.3.2 8英寸晶圆供应情况

- 8.3.3 8英寸晶圆应用领域
- 8.3.4 8英寸晶圆厂建设成本
- 8.3.5 国产8英寸晶圆制造
- 8.4 晶圆代工产业发展格局
 - 8.4.1 全球晶圆代工规模
 - 8.4.2 全球晶圆代工竞争
 - 8.4.3 中国晶圆代工规模
 - 8.4.4 晶圆代工市场现状
 - 8.4.5 晶圆厂商技术布局
- 8.5 中国芯片制造产业发展机遇与挑战
 - 8.5.1 芯片制造面临挑战
 - 8.5.2 芯片制造发展机遇
 - 8.5.3 芯片制造国产化路径

第九章 2021-2023年芯片中游——芯片封测行业分析

- 9.1 2021-2023年中国芯片封测市场运行状况
 - 9.1.1 芯片封测基本概念
 - 9.1.2 芯片封测工艺流程
 - 9.1.3 芯片封测发展现状
 - 9.1.4 芯片封测市场规模
 - 9.1.5 芯片封测竞争格局
 - 9.1.6 芯片封测企业排名
 - 9.1.7 芯片封测企业并购
 - 9.1.8 疫情对行业的影响
- 9.2 芯片封装技术发展水平分析
 - 9.2.1 芯片封装技术演变
 - 9.2.2 中国封装技术水平
 - 9.2.3 先进封装技术历程
 - 9.2.4 先进封装技术类型
 - 9.2.5 先进封装市场规模
 - 9.2.6 先进封装面临挑战
 - 9.2.7 先进封装发展机遇

9.2.8 先进封装市场预测

9.3 芯片封装测试相关设备介绍

9.3.1 测试设备产业链

9.3.2 前道量检测设备

9.3.3 后道测试设备

9.3.4 芯片封装设备

9.3.5 芯片检测设备

第十章 2021-2023年芯片下游——应用领域发展分析

10.1 汽车芯片

10.1.1 汽车芯片产业链

10.1.2 汽车芯片主要类型

10.1.3 全球汽车芯片规模

10.1.4 中国汽车芯片规模

10.1.5 汽车芯片参与主体

10.1.6 汽车芯片企业数量

10.1.7 汽车芯片短缺现状

10.1.8 MCU芯片市场规模

10.1.9 MCU应用领域占比

10.2 人工智能芯片

10.2.1 AI芯片发展现状分析

10.2.2 全球AI芯片市场规模

10.2.3 中国AI芯片市场规模

10.2.4 AI芯片产业链企业发展

10.2.5 AI芯片行业应用情况

10.2.6 AI芯片产业发展问题

10.2.7 AI芯片产业发展建议

10.2.8 AI芯片行业发展趋势

10.3 消费电子芯片

10.3.1 消费电子市场运行

10.3.2 消费电子芯片价格

10.3.3 手机芯片出货规模

- 10.3.4 家电芯片短缺状况
- 10.3.5 家电企业芯片布局
- 10.3.6 电源管理芯片市场
- 10.3.7 LED芯片产业格局
- 10.4 通信行业芯片
 - 10.4.1 射频前端芯片需求
 - 10.4.2 射频前端芯片机遇
 - 10.4.3 射频前端芯片挑战
 - 10.4.4 WiFi芯片发展现状
 - 10.4.5 5G网络设备芯片
 - 10.4.6 5G芯片发展展望
- 10.5 导航芯片
 - 10.5.1 导航芯片基本概述
 - 10.5.2 国外导航芯片历程
 - 10.5.3 北斗导航芯片销量
 - 10.5.4 导航芯片技术现状
 - 10.5.5 导航芯片关键技术
 - 10.5.6 导航芯片面临挑战
 - 10.5.7 导航芯片发展趋势

第十一章 2020-2023年中国芯片产业链重点企业经营分析

- 11.1 台湾积体电路制造公司
 - 11.1.1 企业发展概况
 - 11.1.2 企业研发投入
 - 11.1.3 2021年企业经营状况分析
 - 11.1.4 2022年企业经营状况分析
 - 11.1.5 2023年企业经营状况分析
- 11.2 中芯国际集成电路制造有限公司
 - 11.2.1 企业发展概况
 - 11.2.2 芯片业务现状
 - 11.2.3 企业研发投入
 - 11.2.4 经营效益分析

- 11.2.5 业务经营分析
- 11.2.6 财务状况分析
- 11.2.7 核心竞争力分析
- 11.2.8 公司发展战略
- 11.2.9 未来前景展望
- 11.3 紫光国芯微电子股份有限公司
 - 11.3.1 企业发展概况
 - 11.3.2 芯片业务现状
 - 11.3.3 经营效益分析
 - 11.3.4 业务经营分析
 - 11.3.5 财务状况分析
 - 11.3.6 核心竞争力分析
 - 11.3.7 未来前景展望
- 11.4 杭州士兰微电子股份有限公司
 - 11.4.1 企业发展概况
 - 11.4.2 芯片业务现状
 - 11.4.3 经营效益分析
 - 11.4.4 业务经营分析
 - 11.4.5 财务状况分析
 - 11.4.6 核心竞争力分析
 - 11.4.7 公司发展战略
 - 11.4.8 未来前景展望
- 11.5 北京华大九天科技股份有限公司
 - 11.5.1 企业发展概况
 - 11.5.2 企业经营状况
 - 11.5.3 企业研发投入
 - 11.5.4 主营业务分析
 - 11.5.5 主要经营模式
 - 11.5.6 募集资金用途
 - 11.5.7 未来发展规划
- 11.6 龙芯中科技术有限公司
 - 11.6.1 企业发展概况

- 11.6.2 企业主要产品
- 11.6.3 企业经营状况
- 11.6.4 企业研发投入
- 11.6.5 企业技术水平
- 11.6.6 企业竞争优势
- 11.6.7 募集资金用途
- 11.6.8 未来发展规划
- 11.7 江苏长电科技股份有限公司
 - 11.7.1 企业发展概况
 - 11.7.2 芯片业务现状
 - 11.7.3 经营效益分析
 - 11.7.4 业务经营分析
 - 11.7.5 财务状况分析
 - 11.7.6 核心竞争力分析
 - 11.7.7 公司发展战略
 - 11.7.8 未来前景展望

第十二章 中国芯片产业链投资分析

- 12.1 中国芯片行业投融资状况
 - 12.1.1 芯片市场融资规模
 - 12.1.2 龙头企业融资规模
 - 12.1.3 芯片融资轮次分布
 - 12.1.4 芯片企业科创板上市
 - 12.1.5 芯片产业投资热度
- 12.2 不同市场主体对芯片产业的投资布局
 - 12.2.1 国家集成电路投资基金
 - 12.2.2 大基金一期产业链投资
 - 12.2.3 地方政府投资芯片产业
 - 12.2.4 民间资本投资芯片领域
 - 12.2.5 手机厂商跨界投资芯片
 - 12.2.6 家电企业跨境投资芯片
 - 12.2.7 房地产企业跨界投资芯片

12.3 中国芯片产业链投融资现状

12.3.1 芯片产业链投资数量

12.3.2 芯片设计投资规模

12.3.3 芯片封测投资规模

12.3.4 芯片封测区域投资

12.3.5 投资机构阶段分布

12.3.6 芯片封测投资策略

12.4 中国芯片产业链投资风险及建议

12.4.1 芯片投资驱动因素

12.4.2 芯片企业投资优势

12.4.3 芯片行业投资风险

12.4.4 芯片行业投资壁垒

12.4.5 芯片产业链投资机会

12.4.6 芯片产业链投资策略

12.4.7 芯片项目投资建议

第十三章 2024-2030年中国芯片行业产业链发展前景及趋势分析

13.1 中国芯片产业发展前景展望

13.1.1 芯片行业发展前景

13.1.2 芯片产业发展展望

13.1.3 芯片产业发展机遇

13.1.4 芯片技术研发方向

13.2 芯片产业链发展趋势分析

13.2.1 芯片产业链发展方向

13.2.2 芯片制造设备趋势

13.2.3 芯片设计发展机遇

13.2.4 芯片制造发展趋势

13.2.5 芯片封测发展展望

13.3 中国集成电路产业发展趋势分析

13.3.1 集成电路产业发展方向

13.3.2 集成电路产业发展机遇

13.3.3 集成电路发展趋势特征

13.4 对2024-2030年中国芯片产业预测分析

13.4.1 2024-2030年中国芯片产业影响因素分析

13.4.2 2024-2030年中国集成电路市场规模预测

图表目录

图表1 2016-2020年国内生产总值及其增长速度

图表2 2016-2020年三次产业增加值占国内生产总值比重

图表3 2021年GDP初步核算数据

图表4 2016-2020年全国货物进出口总额

图表5 2020年货物进出口总额及其增长速度

图表6 2020年主要商品出口数量、金额及其增长速度

图表7 2020年主要商品进口数量、金额及其增长速度

图表8 2020年外商直接投资（不含银行、证券、保险领域）及其增长速度

图表9 2020年对外非金融类直接投资额及其增长速度

图表10 2016-2020年全部工业增加值及增速

图表11 中国半导体产业相关政策（一）

图表12 中国半导体产业相关政策（二）

图表13 中国集成电路行业政策汇总（一）

图表14 中国集成电路行业政策汇总（二）

图表15 中国集成电路行业政策汇总（三）

图表16 三代半导体材料对比

图表17 2014-2020年全球半导体市场规模

图表18 2020年全球半导体销售额区域分布结构

图表19 2019-2025年全球半导体行业资本开支走势

图表20 全球半导体行业资本开支各地区占比

图表21 2020年全球半导体行业细分产品市场规模

图表22 2020年全球十大半导体供应商半导体收入

图表23 2020年全球半导体市场企业市场份额

图表24 2015-2020年中国半导体市场规模及增速

图表25 日本半导体产业发展历史

图表26 韩国半导体发展历程

图表27 国内专利排名前十芯片公司

图表28 IGBT芯片技术演变历程

图表29 2020年全球十大芯片公司研发费用汇总

图表30 半导体产业链

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202310/412346.html>